

**Компаунды эпоксидные тиксотропные, покровные, трудногорючие**
**Технические условия:** УБ0.028.041 ТУ

Предназначены для защиты от внешних воздействий и герметизации изделий радиоэлектронной техники (в том числе полупроводниковой техники, интегральных микросхем) и электротехники, эксплуатирующихся в интервале температур -60 ... +155 °С, при относительной влажности воздуха до 95%.

- Отличаются длительной жизнеспособностью.
- Смешиваются в сухом виде с последующим совмещением с растворителями.

<b>Основные характеристики</b>	
Удельное объемное электрическое сопротивление	
- при +20 °С	10 <sup>12</sup> Ом·м
- при +155 °С	10 <sup>8</sup> Ом·м
- после выдержки в течение 1000 часов в условиях тропической влажности	10 <sup>8</sup> Ом·м
Тангенс угла диэлектрических потерь (f = 10 <sup>3</sup> Гц), не более	
- при +20 °С	0,05
- при +155 °С	0,10
- после выдержки в течение 1000 часов в условиях тропической влажности	0,10
Влагопоглощение после 1000 часов испытаний в условиях тропической влажности	1,2 ... 1,5%
Внутренние напряжения	2,3 МПа
Механическая прочность по Динстату	0,28 МПа
Адгезия к стальной проволоке	23,0 МПа
Жизнеспособность (неотвержденный компаунд)	
- сухой смеси	6 мес
- жидкого компаунда	0,5 мес
Режим полимеризации	80/12 или 100/6 или 120/3 °С/ч

**Обозначение при заказе:** Компаунд эпоксидный Э-4А УБ0.028.041 ТУ